

Februar 2008

CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing b. München

Telefon +49 (0)8092-7005-0
E-Mail marketing@cadfem.de

Telefax +49 (0)8092-7005-77
Internet www.cadfem.de

Wenn Sie **Rückfragen** zu nachstehender Meldung haben, **weitergehende Informationen**, eine **elektronische Version** oder **Bildmaterial** dazu benötigen, wenden Sie sich bitte an **Alexander Kunz**, Telefon **0711-990 74 5-20**, E-Mail akunz@cadfem.de

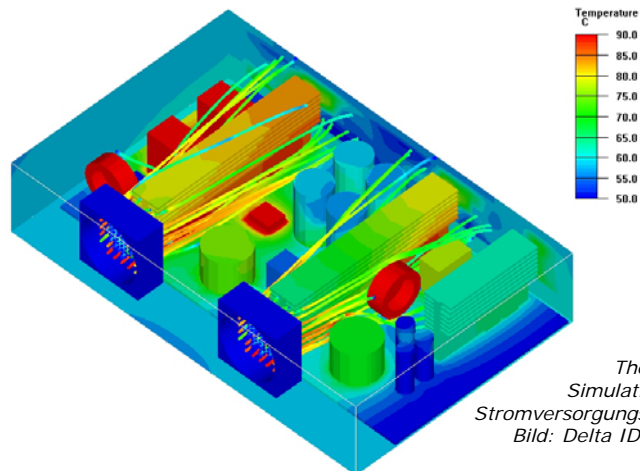
Technische Informationstage

Thermal Management: Effiziente Elektronikentwicklung durch strukturmechanische, elektromagnetische und strömungsmechanische Simulationen

Produkte der Leistungselektronik oder Elektroantriebe werden zunehmend komplexer. Mit dem permanent wachsenden Leistungsvermögen der Bauelemente in der Leistungselektronik, bei gleichzeitig zunehmender Volumenkonzentration in Gehäusen, steigen auch die Anforderungen an das Wärmemanagement der Produkte.

Um den Planungs- und Entwicklungsprozess komplexer Systeme effizient zu gestalten, kommt heute **Simulationswerkzeugen** eine wichtige Rolle zu. Die Programmpakete ANSYS

Multiphysics, ANSYS Emag und ANSYS ICEPAK für die Berechnung thermischer, mechanischer und elektromagnetischer Phänomene haben sich hier fest am Markt etabliert.



Thermische
Simulation eines
Stromversorgungsmoduls.
Bild: Delta IDL GmbH

Die CADFEM GmbH gibt an technischen Informationstagen gezielt den Entwicklern aus der Elektro- und Elektronikindustrie einen Überblick über das aktuelle Simulationspektrum von ANSYS. Die Veranstaltung rückt die besonderen Anforderungen dieser Branche in den Mittelpunkt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem **Thermal Management** und auf strukturmechanischen, elektromagnetischen und strömungsmechanischen Anwendungen – inklusive der Kopplung verschiedener physikalischer Phänomene. An praktischen Beispielen mit **Live-Demonstrationen** der Software, werden die Vorgehensweise und die Möglichkeiten der Simulation im Entwicklungsprozess gezeigt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei möglich.

Inhalte

- Thermisches Management
- Mechanische Analysen (Festigkeit, Dynamik)
- Thermische Analysen (Chipgehäuse, PCB)
- Strömungsmechanische Analysen (Kühlung)
- Analyse mechatronischer Systeme (Aktuatoren, Sensoren)
- Elektrische Antriebe
- Thermische Analyse der Leistungselektronik
- Gekoppelte Berechnungen
- Live-Beispiele:
 - Leiterplatte: Thermomechanik und Schwingung
 - Kühlung kompletter elektronischer Geräte
 - Thermoelektrisches MEMS
 - Piezoelektrische Aktuatoren / Piezoresistive Sensoren
- Fragen und Antworten, Diskussion

Termine

- 03. April 2008 in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart
- 14. Mai 2008 in Aadorf (CH, Bodenseeraum)
- 02. Juni 2008 in Grafing bei München
- 04. Juni 2008 in Wien (A)
(jeweils von 10 – ca. 17 Uhr)

Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen können auf der Homepage der CADFEM GmbH unter www.cadfem.de vorgenommen werden.

Über ANSYS

Als hochspezialisierter Technologie-Anbieter, der sich seit über 30 Jahren vollständig auf den anspruchsvollen Simulationsbereich konzentriert, ist ANSYS, Inc. mit einem durchgängigen Portfolio von High-End-Simulationssoftware für die Produktentwicklung exzellent aufgestellt. In ANSYS Multiphysics hat ANSYS mit den Programmen ICEPAK, ICEBOARD und ICECHIP optimale Werkzeuge für die Simulation in der Elektronikumgebung.

www.ansys.com

CADFEM GmbH



CADFEM bietet neben führenden Softwarelösungen wie ANSYS, LSDYNA und FTI ein breites Spektrum an

Dienstleistungen und Schulungen rund um die rechnerische Simulation. Bereits seit 1985 ist CADFEM das ANSYS FEM-Kompetenzzentrum in Zentraleuropa. Sitz des Unternehmens, das sich als Ingenieurbüro und Systemhaus versteht, ist Grafing bei München. Darüber hinaus gibt es weitere Geschäftsstellen in Deutschland sowie Partner in Europa, Asien und den USA. Neben dem Vertrieb von Softwarelösungen, ist CADFEM der kompetente Partner für Auftragsberechnungen (u.a. Statik/Dynamik, Crash, Umformung, Mechatronik, Strömung, Betriebsfestigkeit, Akustik, Temperaturfelder), kunden- und branchenspezifische Produktweiterentwicklungen sowie Hard-/Software-Komplettlösungen.

www.cadfem.de

ANSYS Germany

Competence Center CFD

ANSYS Germany ist die deutsche Niederlassung von ANSYS Inc., USA, einem der weltweit führenden Anbieter von

Simulationssoftware. Die beiden Hauptstandorte sind Otterfing bei München und Darmstadt. ANSYS Germany ist in Zentraleuropa das ANSYS CFD-Kompetenzzentrum und bietet zu den ANSYS-CFD-Lösungen das gesamte Spektrum an Dienstleistungen.

www.ansys-germany.com

Kooperation ANSYS & CADFEM

Beide Unternehmen arbeiten in enger Kooperation mit einem Schwerpunkt in ihren jeweiligen Kompetenzen und bieten ihren Kunden somit optimale Unterstützung in allen Fragen der Anwendung der ANSYS Multiphysics Software Suite an.

Informationstage
Simulation in der Elektronik
April, Mai & Juni in D, A und CH
Information & Anmeldung: www.cadfem.de

Die hier vorgestellten Software-Werkzeuge zur Elektronik-Simulation werden von CADFEM auf folgenden Fachmessen präsentiert:



Bayern Innovativ: Innovations in Microsystems

4. – 5. März 2008,
Arabella Sheraton Bogenhausen Hotel, München
www.bayern-innovativ.de/microsystems2008
CADFEM Stand in der begleitenden Fachausstellung



DATE 2008

Design, Automation and Test in Europe

10. – 14. März 2008,
ICM München
www.date-conference.com
CADFEM Stand B7



EuroSimE

Thermal, Mechanical and Multiphysics Simulation and Experiments in Micro-Electronics & Micro-Systems

21. – 23. April 2008,
Konzerthaus Freiburg
www.eurosime.org
CADFEM Stand in der begleitenden Fachausstellung



Hannovermesse 2008 / Digital Factory

21. – 25. April 2008,
Hannover
www.hannovermesse.de
CADFEM Stand in Halle 17, Stand F50

Kontakt:

CADFEM GmbH, Marktplatz 2, 85567 Grafing bei München, Telefon +49 (0)8092-7005-0, Telefax +49 (0)8092-7005-77, E-Mail marketing@cadfem.de, Internet www.cadfem.de.

Ende